

# 2020-2026年中国LED用 衬底材料市场发展态势与市场前景预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

# 一、报告报价

《2020-2026年中国LED用衬底材料市场发展态势与市场前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/S577502UFI.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

硅衬底LED芯片是GaN基在硅衬底上制造的一种led芯片，硅衬底LED芯片问世不久，但是在硬度、导电性、导热性、价格及加工工艺上已经相较传统LED芯片有了明显的优势，受到业界的广泛关注。智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国LED用衬底材料市场发展态势与市场前景预测报告》分析了LED用衬底材料行业的产业链，竞争格局，面临的机遇及挑战以及发展前景等，您若想对中国LED用衬底材料行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录:第一章 半导体照明(LED)产业概述第一节 全球LED产业现状与发展一、全球半导体照明产业发展现状二、全球半导体照明市场基本格局三、全球半导体照明产业重点区域及企业现状第二节 中国LED产业现状与发展一、中国LED产业发展现状二、中国半导体照明产业快速增长三、中国LED照明企业的发展特征四、中国半导体照明产业的发展优势第三节 中国LED市场现状一、中国半导体照明产业的市场格局二、中国半导体照明产业的区域分布三、全国主要半导体产业基地及潜力点第四节 半导体照明产业链的重要环节一、半导体照明产业链概述二、上游环节产业链三、中游环节(芯片制备)产业链四、下游环节(封装和应用)产业链 第二章 LED用衬底材料的相关概述第一节 LED外延片基本概述第二节 红黄光LED衬底第三节 蓝绿光LED衬底 第三章 蓝宝石衬底第一节 蓝宝石衬底的概述一、蓝宝石衬底材料的介绍二、外延片厂商对蓝宝石衬底的要求三、蓝宝石生产设备的情况四、蓝宝石晶体工艺介绍第二节 蓝宝石衬底材料市场调研一、全球蓝宝石材料市场概述二、国内的技术现状三、我国存在的困境分析第三节 蓝宝石项目生产概况一、原料二、生产线设备三、2014-2017年国内蓝宝石材料项目介绍第四节 市场对蓝宝石衬底的需求分析一、民用半导体照明领域对蓝宝石材料的需求分析二、民用航空领域对蓝宝石衬底的需求分析三、军工领域对蓝宝石材料的需求分析四、其他领域对蓝宝石材料的需求分析第五节 蓝宝石衬底材料的趋势预测一、2017年蓝宝石衬底市场趋势预测二、蓝宝石衬底材料的发展趋势 第四章 硅衬底第一节 半导体硅材料的概述一、半导体硅材料的电性能特点二、半导体硅材料的制备三、半导体硅材料的加工四、半导体硅材料的主要性能参数第二节 硅衬底LED芯片主要制造工艺的综述一、Si衬底LED芯片的制造二、Si衬底LED封装的技术三、硅衬底LED芯片的测试结果第三节 硅衬底上GAN基LED的研究进展一、用硅作GaN LED衬底的优缺点二、硅作GaN LED衬底的缓冲层技术三、硅衬底的LED器件 第五章 碳化硅衬底第一节 碳化硅衬底的介绍一、碳化硅的性能及用途二、LED碳

化硅衬底的基础概要第二节 SiC半导体材料研究的阐述一、SiC半导体材料的结构二、SiC半导体材料的性能三、SiC半导体材料的制备方法四、SiC半导体材料的应用第三节 SiC单晶片CMP超精密加工的技术分析一、SiC单晶片超精密加工的发展二、SiC单晶片的CMP技术的原理三、SiC单晶片CMP磨削材料去除速率四、SiC单晶片CMP磨削表面质量五、CMP的影响因素分析六、SiC单晶片CMP抛光存在的不足七、SiC单晶片的CMP的趋势 第六章 砷化镓衬底第一节 砷化镓的介绍一、砷化镓的定义及属性二、砷化镓材料的分类第二节 砷化镓在光电子领域的应用一、砷化镓在LED方面的需求市场二、我国LED方面砷化镓的应用第三节 砷化镓衬底材料的发展一、国外砷化镓材料技术的发展二、国内砷化镓材料技术的发展三、国内砷化镓材料主要生产厂家的情况四、砷化镓外延衬底市场规模预测 第七章 其他衬底材料第一节 氧化锌一、氧化锌的定义二、氧化锌的物理及化学性质第二节 氮化镓一、氮化镓的介绍二、GaN材料的特性三、GaN材料的应用四、氮化镓材料的应用前景广阔 第八章 重点企业第一节 国外主要企业一、京瓷 (Kyocera) 二、Namiki三、Rubicon四、Monocrystal五、CREE第二节 中国台湾主要企业一、台湾越峰电子材料股份有限公司二、台湾中美硅晶制品股份有限公司三、台湾合晶科技股份有限公司四、台湾鑫晶钻科技股份有限公司第三节 中国大陆主要企业一、哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司二、云南省玉溪市蓝晶科技有限责任公司三、成都聚能光学晶体有限公司四、青岛嘉星晶电科技股份有限公司五、爱彼斯通半导体材料有限公司 ( ) 第九章 投资分析第一节 2017年将是LED照明产业最佳投资时期第二节 LED行业上游投资前景分析

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jiancai/S577502UFI.html>